



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202026562 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 02

(21) 申请号 201120064353. X

(22) 申请日 2011. 03. 11

(73) 专利权人 深圳瑞谷电子有限公司

地址 518000 广东省深圳市南山区高新南环路 29 号留学生创业大厦 13 楼 07 号

(72) 发明人 杜能

(51) Int. Cl.

H05K 9/00 (2006. 01)

H05K 7/20 (2006. 01)

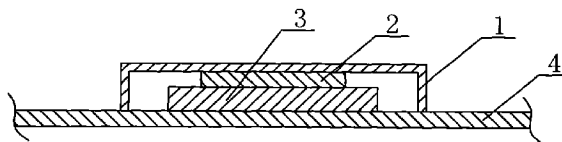
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带散热功能的屏蔽罩

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带散热功能的屏蔽罩。包括屏蔽罩、导热胶、IC、印刷电路板；在印刷电路板上设有 IC，屏蔽罩罩在 IC 的上方，在屏蔽罩与 IC 之间设有导热胶。本实用新型结构简单、成本低、IC 散热效果好。



1. 带散热功能的屏蔽罩,其特征在于:包括屏蔽罩、导热胶、IC、印刷电路板;在印刷电路板上设有 IC,屏蔽罩罩在 IC 的上方,在屏蔽罩与 IC 之间设有导热胶。

带散热功能的屏蔽罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种屏蔽罩,尤其涉及一种带有导热胶的屏蔽罩。

背景技术

[0002] IC 在工作的时候会产生大量的热,特别是满负荷工作的时候产生的热量更大,如果这些热量不及时散发出去的话,将对 IC 的稳定性、寿命等都会产生很大的影响,而市面上的 IC 屏蔽罩将 IC 全罩在里面并且屏蔽罩与 IC 均有较大的空隙,由于空气是热的不良导体,所以 IC 产生的热不容易散发出去。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足而提供一种在 IC 和屏蔽罩之间设有导热胶,将 IC 产生的热量通过导热胶尽快的散发出去。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 带散热功能的屏蔽罩,包括屏蔽罩、导热胶、IC、印刷电路板;在印刷电路板上设有 IC,屏蔽罩罩在 IC 的上方,在屏蔽罩与 IC 之间设有导热胶。

[0006] 在 IC 工作时产生的热量,通过 IC 与屏蔽罩之间的导热胶传导到屏蔽罩上,再由屏蔽罩将热量散发出去。

[0007] 本实用新型结构简单、成本低、IC 散热效果好。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型示意图。

[0009] 图中 1、屏蔽罩,2、导热胶,3、IC,4、印刷电路板。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示,带散热功能的屏蔽罩,包括屏蔽罩 1、导热胶 2、IC3、印刷电路板 4;在印刷电路板 4 上设有 IC3,屏蔽罩 1 罩在 IC3 的上方,在屏蔽罩 1 与 IC3 之间设有导热胶 2。

[0011] 在 IC3 工作时产生的热量,通过 IC3 与屏蔽罩 1 之间的导热胶 2 传导到屏蔽罩 1 上,再由屏蔽罩 1 将热量散发出去。

[0012] 根据上述说明书的揭示和教导,本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式适当的变更和修改。因此,本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本实用新型构成任何限制。

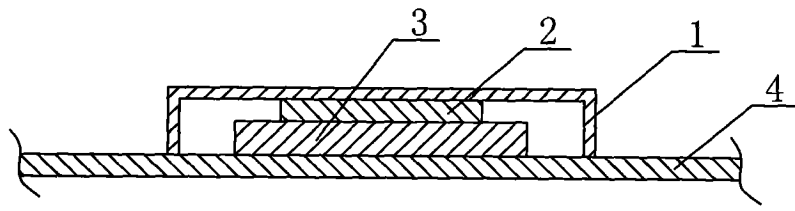


图 1